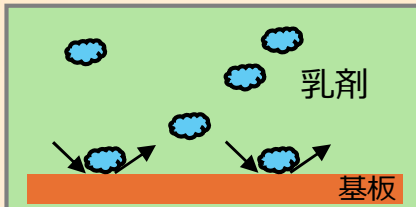


サテン調めっき

KASUMIプロセス

エマルジョン法 (1段処理)

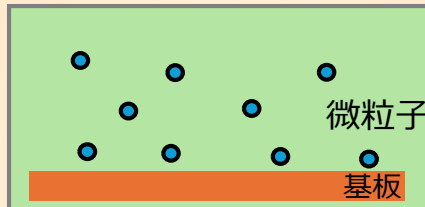


乳剤が表面に付着→脱離



めっき析出が阻害され
半円状のくぼみができる

コンポジット法 (1段処理)



微粒子が付着

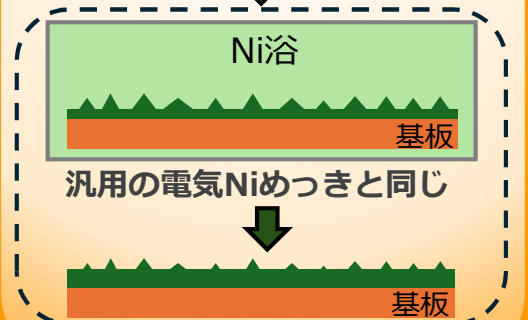


微粒子が共析

KASUMI (2段処理)



異方析出



平滑化しサテン調へ

<下地 : Ni>

<下地 : Cu>

カバー
めっき

<Ni / Cr>

- 加熱による変色、接触抵抗の上昇が少ない
- 分析による定量管理が可能
- 用途: 機能的部品

株式会社ムラタ

●本社・工場 / 〒651-0071

神戸市中央区筒井町2-2-8

TEL (078)221-7071

FAX (078)221-7074

●東日本営業所 / 〒111-0041

東京都台東区元浅草1-8-6

TEL (03)5811-1951

FAX (03)5811-1952

MURATA Co.,Ltd.